



超眾科技股份有限公司

CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP.

致股東報告書

各位股東、各位女士、先生大家好：

本人謹代表董事會及全體員工感謝諸位股東對本公司之支持與愛護。同時敬向諸位股東報告，本公司民國一〇七年度經營成果及民國一〇八年度經營計劃。

一、民國一〇七年度營業報告

(一) 民國一〇七年度營業計劃實施成果

本公司一〇七年度合併營業收入淨額新台幣 7,662,175 千元，較一〇六年度 7,067,221 千元增加 8%；稅前淨利新台幣 931,048 千元，較一〇六年度 665,056 千元增加 40%；稅後淨利為新台幣 595,610 千元及每股盈餘 6.90 元與前一年度相較，增加 19%。營收成長以及匯率不利因素消失致本年度稅前淨利成長。

分析散熱產業概況，隨著雲端(Cloud)、人工智慧(AI)以及 5G 等相關技術逐漸成熟發展，以往散熱產品應用著重於 PC 等個人裝置相關產業已擴及智慧型手機、雲端資料中心、互聯網、汽車、通訊、資訊運算設施及智慧家電等領域。整體散熱產品需求與市場規模皆持續加速成長；為配合需求面提升，供給面也持續擴增產能，提供更多元化的散傳熱相關產品。因應市場變化，本公司將持續深耕既有客戶群，並且積極開發手持裝置散熱、高瓦特數氣冷散熱以及液冷散熱以滿足市場需求。佈局 AI 及 5G 等相關應用所帶動的產品發展為目標，全面提升全球重點區域/客戶之連結，以持續強化現有客戶的服務以及新客戶之開發。

研發技術發展持續朝輕、薄、強(Slight、Slim、Strong) 3S 散熱方案開發，除 5G 通訊設備使用之高功率熱管、熱板開發完成與陸續導入量產之外，智慧手機運用的極薄熱板亦完成開發步入量產階段。接著將基於此成功開發基礎精進製程技術，持續提升產品良率。因應未來更複雜、更高功率的散熱運用，如光聯結器、小基站…等散熱方案，將可能使用耐磨耗熱板與多迴路液冷循環，公司亦擴大投入開發，期以領先同業備妥方案，滿足日益廣泛的解熱需求。

展望未來，公司於一〇八年初已加入新的經營團隊，未來將有更強大的資源、技術能力、產品線與客戶群的支援，相信經過密切的

團隊合作，在可預期的未來將會發揮可觀的綜效。至於產品策略方面，將持續致力於產品性能朝更薄、更小、結構更強與散熱功率更高的方向發展，展開雙臂迎接更多元散熱應用之大趨勢。在人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、雲端(Cloud)、5G、高效能運算(HPC)、智慧家電與車用等應用領域擴大營運廣度與深度，以氣冷與液冷等散熱方案來滿足市場需求。至於不確定因素則包括大國間之貿易戰、全球安全變動風險、原物料價格波動、人工等營運成本增加與產品價格競爭等…，公司將持續技術、產品與應用面的創新、提升產能與生產力、適度調整產品製造地點，以確保核心競爭力與綜合經營績效持續領先同業。

(二) 預算執行情形：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司未公開民國一〇七年度財務預測資訊，無需揭露一〇七年度預算執行分析資料。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

	項目	106 年度	107 年度
財務收支	營業收入	7,067,221	7,662,175
	營業毛利	1,463,166	1,551,889
	稅後淨利	500,265	595,610
獲利能力	資產報酬率(%)	7.62	8.91
	權益報酬率(%)	13.55	16.01
	稅前淨利佔實收資本額(%)	77.02	107.83
	純益率(%)	7.07	7.77
	基本每股盈餘(元)	5.79	6.90

(四) 研究發展狀況

1. 最近二年度研究發展支出

單位：新台幣千元

年 度	106年度	107年度
研究發展費用金額	267,061	290,193
佔當年度營收比率(%)	3.78	3.79

2. 研究發展成果

- (1) 350微米(μm)超薄熱板方案 - 高性能電競手機散熱模組開發完成。
- (2) 高功率數據交換機仟瓦 (KW) 氣冷方案散熱模組開發完成。

二、民國一〇八年度營業計劃概要

(一) 經營方針

- 1.整合公司管理系統，取得即時資訊以提升決策效率與決策品質。
- 2.建立全球競爭能力與視野，落實政策執行力。
- 3.持續加強供應鏈之開發、管理，以有效控制來料成本。
- 4.主動與客戶建立良好互動，滿足客戶多元需求，加強及時客訴處理、預防矯正、再發防止措施確實導入執行。
- 5.注重市場資訊之蒐集，包括產業動態、財經資訊，以供決策參考。
- 6.加速導入自動化及生產設備、儀器適時更新，持續改善製程，提升生產力。
- 7.加強產品創新、研發計劃，適度與研究機構技術合作，掌握公司未來中長期新高技術的可靠來源。
- 8.持續進行資訊系統整合管理，簡化作業流程以及逐步導入無紙化，提升效率。

(二) 預計銷售數量及其依據

本公司主要銷售產品為熱管、熱板相關散熱模組及散熱片；主要產品線應用以個人電腦產業(PC)、伺服器(Server)、網路通信、智慧型手機等為主。根據國際研究暨顧問機構 Gartner 預測，2019 年傳統 PC 市場將呈現微幅萎縮，但因高階機種持續成長，全球整體 PC 出貨量約 2.6 億台(DT+NB)。在網路設備方面，因應 5G 世代即將來臨，相關設備將全面更新，應用領域更是全面涵蓋，結合 LPWAN 聯網技術、AR/VR、自駕車、無人機、機器人等新興載具，為各產業帶來更多創新應用與市場機會，例如全自動化 AI 電網、無人機安防監控、無人車接駁、AR/VR 購物等，將帶動整體資訊產業的應用全面升級與效能之提升。在伺服器(Server)方面，預計 2019 年全球伺服器出貨量將年成長約 7%。在智慧型手機(Smart Phone)方面，雖然全球總出貨量僅微幅成長，但是因應手機功耗持續提升與 5G 手機開始出貨，熱管、熱板等相關散熱裝置的使用量與滲透率將大幅提升。整體而言，本公司民國一〇八年度出貨量將持續成長，預計合併銷售數量如下：

單位：千組/千片

主要產品	全年預計銷售量	截至 108.03.31 止	
		已銷售之數量	已達百分比(%)
散熱模組	70,364	13,645	19%
散熱片	26,984	6,450	24%
其他	11,155	3,975	36%
合計	108,503	24,070	22%

(三) 重要之產銷政策

生產方面：因為散熱產品的產業特性為標準件少、設變頻繁且下單急促，故本公司嚴格管理庫存及降低庫存量，並提高存貨週轉能力。此

外，積極投入自動化生產設備，降低人力需求，並提升生產品質和製程簡化改善，設計共用性材料，以有效降低成本，進而提供更具競爭力的價格。

銷售方面：除深根既有國內外市場佔有率外，視市場供需情形，逐步增加熱板產能投資。另加強海外行銷佈局，建立代理銷售管道積極開拓國際市場。

三、未來公司發展策略

- (一) 設定短、中、長期之目標及願景。
- (二) 依設定之目標願景，全面展開行動計畫，定期追蹤執行成效並機動策略調整。
- (三) 擴大產品服務範圍與產業類別，取得各產品線在同業間之相對優勢位置。
- (四) 提升研發技術質量與能量，與客戶共同分享研發成果與營收成長之績效。
- (五) 加速產能提升，以滿足未來市場需求。
- (六) 積極提升自動化生產製程，以提高效率與有效控制成本。
- (七) 持續提升產品品質，以達到出貨產品零缺失的目標。
- (八) 持續加強產業之環保政策，節能、減排、營造友善環境與勞動條件，實現低碳、無碳產業、符合 RBA (EICC) 規範，善盡社會責任。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

公司自創立經營以來無時不面臨外部競爭、法規及總體經營環境之影響。公司面對外部市場競爭、證券主管機關頒布的新的法令、國外環保法令，以及全球瞬息萬變經營環境，確實影響公司營運表現。本公司為因應上述各環境變化，除遵循證券主管機關頒布的新的法令編製報表及要求供應商與公司產品符合國外環保法令外，將致力強化供應鏈整合，提升零組件自製率，改良生產製程、擴大產能以降低生產成本，並即時掌握客戶訂單需求做好原物料採購規劃，以提升公司整體的競爭力。

最後 敬祝

身體健康 闔家平安

董事長：永井淳一



總經理：郭大祺



會計主管：伊玲娟

